产品说明书
Technical Data Sheet

K-HC 400E系列 导热硅胶片

版本：B0

产品概述：

K-HC 400E是一款通用型导热垫片，能满足对硬度没有特殊要求的散热需求，其柔软性可以满足大部分压力装配要求，表现出较小的热阻，同时排除元器件和电路板之间的空气，充分填充各类粗糙的表面。该产品自带粘性。默认为无基材结构，可以定制为有基材结构，如背矽胶布/3M胶/玻璃纤维等工艺以满足特殊要求。

产品特点：

- 热传导率=4.0W/m.k
- 高贴服，超低硬度，适合低紧固压力
- 防火满足V0,环保符合ROHS要求
- 抗刺破，抗剪切和抗撕裂

典型应用：

- 通讯行业
- 电脑及外围 功率转换器
- 半导体或磁性体与散热片之间
- 需要传热的框架 ，底盘或者其他热传导器的区域

技术参数

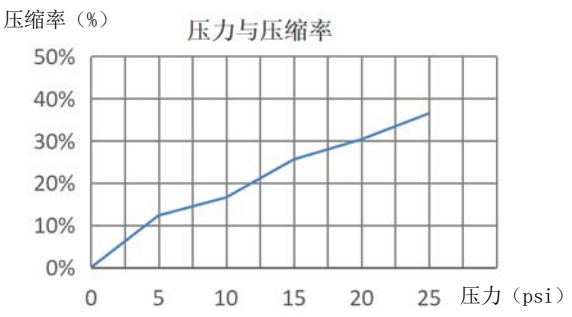
主要物性		
产品性能	**测试值**	**测试方法**
材质	有机硅改性高分子材料 与导热填充材料聚合物	—
颜色	深灰色	Visual
厚度范围(mm)	0.5 -10.0	ASTM D374
密度(g/cm³)	3.2±0.2	ASTM D792
硬度（Shore C）	20-50（±5）	ASTM D2240
绝缘击穿电压 (KV/AC@1.0mm)	≥8	ASTM D149
介电常数（1.2MHz）	≥5.5	ASTM D150
体积电阻率(Ω.cm)	$\geq 1.0*10^{13}$	ASTM D257
耐温范围（℃）	-40 ~ 200	EN344
重量损失(%)	≤1	200℃ 4H
防火等级	V0	UL 94
导热系数（W/m-K）	≥4.0	ASTM D5470

厚度公差≤产品厚度的10%

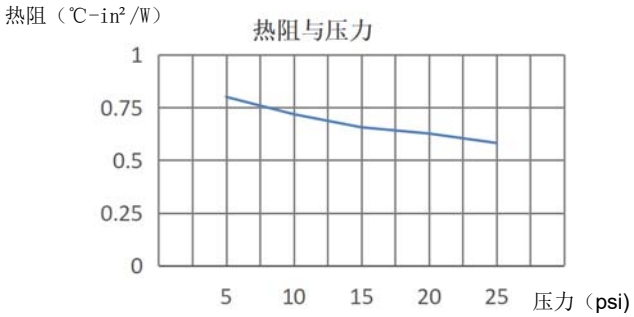
可供规格 ：片材，模切

标准厚度mm：0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0其它厚度需定制；
标准长宽mm：200*400,300*400,其它尺寸需定制；
储存条件：温度 5℃-38℃、湿度 35%-75%RH；

压缩曲线图（2.0mm）



热阻曲线图



特别说明
本说明书的数据是实验室条件下获得，由于使用环境的差异，使用者要参照这些数据和使用条件进行分析和试验。跨越电子不担保销售产品和特定工况下使用跨越电子产品出现的问题，不承担任何直接，间接或意外损失责任。用户在使用过程遇到什么问题，可以和跨越电子技术服务部门联系，我们将为您提供一切帮助。

东莞市跨越电子有限公司
Dongguan Kuayue Electronics Co., Ltd

地址(ADD)：东莞市东坑镇正崴五路3号翔天科技园
电话(TEL)：0769-83699986
手机(M/T)：186-8008-3066
邮箱(E-Mail)：susan@kuayueyzy.com